



■ 出展製品

グループ名	No.	製品/技術
光を制御する材料	1	レーザーアプリケーション用YAGセラミックス
	2	ITO・IZO・IGZO(ディスプレイ用)、NS(光学膜用)スパッタリングターゲット
Pbフリー圧電材料	3	Pbフリー圧電素子向け AlSc・KNNスパッタリングターゲット
コンデンサ材料	4	コンデンサ用タンタル粉末・タンタルペースト <H.C Starck Tantalum and Niobium GmbH>
高純度塩化金属	5	ALD・CVD用高純度塩化金属
	6	“AMPERTEC®”タンタル・ニオブ塩化物 粉末 <H.C Starck Tantalum and Niobium GmbH>
高機能実装材料	7	実装ペースト/低固有抵抗Agボンディングワイヤ <タツタ電線>
	8	ソフトエラー対策用 低α錫
精密金属加工	9	プレス加工・樹脂成形加工
	10	精密めっき加工
	11	機能性表面処理剤 <JX金属商事>
高機能チタン	12	焼結チタン・チタン合金部品 <東邦チタニウム>
	13	高機能チタン合金粉末 <東邦チタニウム/トーホーテック>
FPC用高屈曲銅箔	14	FPC用高機能圧延銅箔“HA & HA-V2箔”
	15	FPC用電解銅箔“JXEFLシリーズ”

グループ名	No.	製品/技術
3Dプリンター用金属粉	16	チタン系粉末(純チタン粉、水素化粉、64合金粉) <東邦チタニウム/トーホーテック>
	17	“AMtrinsic®”3Dプリンター用タンタル・ニオブ合金粉末 <H.C Starck Tantalum and Niobium GmbH>
	18	3Dプリンター用銅粉
高速・高信頼通信を支える材料	19	化合物半導体基板 (InP, CdZnTe)
	20	ファインピッチおよび高周波用銅箔 “BHM処理”
電磁波シールド	21	メタルカン用シールドテープ <タツタ電線>
	22	3D成形可能な電磁波シールドシート
	23	電磁波シールド用Sn-Cu-PET箔
熱を制御する材料	24	熱膨張の制御を可能にする 負熱膨張材: ZrW <sub>2</sub> O <sub>8</sub>
	25	高温域対応の潜熱蓄熱マイクロカプセル
	26	高導電銅合金 - コルソン合金 -
次世代Liイオン電池材料	27	Liイオン伝導性固体電解質セラミックス“LLTO™” <東邦チタニウム>
	28	Liイオン電池用高強度圧延銅箔

セミナーの詳細は裏面をご覧ください

## ■ セミナータイトルおよび概要

	セミナータイトル	セミナー概要
A	高温度域向け潜熱蓄熱マイクロカプセル “開発品”	熱利用の回収やその利用が期待されている高温度域に向けて、金属合金とセラミックスシェルを持ち高蓄熱密度を実現する潜熱蓄熱材料の特徴をご紹介します。
B	熱すると収縮する負熱膨張材： ZrW <sub>2</sub> O <sub>8</sub> の開発について	熱膨張の制御に向けて近年注目されている負の熱膨張材。JX金属では幅広い温度範囲で負の熱膨張特性を示すZrW <sub>2</sub> O <sub>8</sub> 粉の開発を進めております。本セミナーではその開発状況と、実際の効果についてご紹介いたします。
C	軽量で、高いシールド性能を有する 電磁波シールドシート	JX金属にて開発・製造しております軽量で、高いシールド性能を有する3D成形可能なシールドシート（開発品）とSn-Cu-PETシールドシートについて特徴と用途例をご紹介します。
D	レーザー向け透明性セラミックス -YAG- “開発品”	一般的にYAG (Yttrium Aluminum Garnet) はレーザー結晶として発振器や増幅器に用いられます。単結晶相当の高い透過率をもつ大型YAGセラミックスの特徴をご紹介します。
E	高導電コルソン合金の紹介	電子機器の大電流通電、発熱量低下などといった市場のニーズにお応えした、高導電のコルソン合金についてご紹介いたします。
F	Display用酸化物材料 -ITO・IZO・IGZO・NS-	LCD、OLEDを含むDisplay及びSensorなどに使われる透明電極材 (ITO、IZO) と酸化物半導体 (IGZO)、光学調整材 (NS Seires) をご紹介いたします。
G	半導体用スパッタリングターゲット -Ti・Cu・Ta-	半導体用スパッタリングターゲットの基本的な使い方、JX金属取り扱い製品範囲、主要製品の基本特性をご紹介します。
H	3Dプリンター用先端金属粉末 -Cu・Ti・Ta・Nb-	JX金属、トーホーテックおよびH.C.Starck Tantalum and Niobium GmbHにて開発・製造しておりますCu、Ti、Ta、Nbを中心とした3Dプリンター用先端金属粉末の特徴と用途例をご紹介します。
I	JXPTの精密加工技術 -電子機器の小型化・高信頼化を支える-	お客様のご要望に合わせ、プレス・めっき個別の加工から一貫対応まで、どのようなご要望にもスピーディーに対応するJX金属プレジジョンテクノロジー (JXPT) の精密加工技術をご紹介します。
J	高耐食性Au封孔処理剤のご紹介	JX金属商事ではコネクタやリードフレーム用途の金属表面処理剤を開発販売しております。本セミナーでは、種々の金属表面処理剤の概要をご説明いたします。また、特にコネクタ用硬質Auめっきに適用する高耐食性封孔処理剤の特徴をご紹介します。

## ■ タイムテーブル

	12月4日 (水)	12月5日 (木)	12月6日 (金)
10:00			
10:30			H 3Dプリンター用先端金属粉末 -Cu・Ti・Ta・Nb-
11:00	A 高温度域向け潜熱蓄熱マイクロカプセル “開発品”	E 高導電コルソン合金の紹介	I JXPTの精密加工技術 -電子機器の小型化・高信頼化を支える-
11:30	B 熱すると収縮する負熱膨張材： ZrW <sub>2</sub> O <sub>8</sub> の開発について	F Display用酸化物材料 -ITO・IZO・IGZO・NS-	J 高耐食性Au封孔処理剤のご紹介
12:00	C 軽量で、高いシールド性能を有する 電磁波シールドシート	G 半導体用スパッタリングターゲット -Ti・Cu・Ta-	
12:30	D レーザー向け透明性セラミックス -YAG- “開発品”		
13:00			A 高温度域向け潜熱蓄熱マイクロカプセル “開発品”
13:30		H 3Dプリンター用先端金属粉末 -Cu・Ti・Ta・Nb-	B 熱すると収縮する負熱膨張材： ZrW <sub>2</sub> O <sub>8</sub> の開発について
14:00	E 高導電コルソン合金の紹介	I JXPTの精密加工技術 -電子機器の小型化・高信頼化を支える-	C 軽量で、高いシールド性能を有する 電磁波シールドシート
14:30	F Display用酸化物材料 -ITO・IZO・IGZO・NS-	J 高耐食性Au封孔処理剤のご紹介	D レーザー向け透明性セラミックス -YAG- “開発品”
15:00	G 半導体用スパッタリングターゲット -Ti・Cu・Ta-		
15:30		A 高温度域向け潜熱蓄熱マイクロカプセル “開発品”	E 高導電コルソン合金の紹介
16:00	H 3Dプリンター用先端金属粉末 -Cu・Ti・Ta・Nb-	B 熱すると収縮する負熱膨張材： ZrW <sub>2</sub> O <sub>8</sub> の開発について	F Display用酸化物材料 -ITO・IZO・IGZO・NS-
16:30	I JXPTの精密加工技術 -電子機器の小型化・高信頼化を支える-	C 軽量で、高いシールド性能を有する 電磁波シールドシート	G 半導体用スパッタリングターゲット -Ti・Cu・Ta-
17:00	J 高耐食性Au封孔処理剤のご紹介	D レーザー向け透明性セラミックス -YAG- “開発品”	
17:30			
18:00			